

Neuer Prozess

Das Packaging von integrierten Schaltkreisen (IC) oder ganzen Systemen (SiP) ist heutzutage nur in hohen Stückzahlen oder in standardisierten Maßen kosteneffizient realisierbar. Der KONEKT Ansatz bietet Lösungen für hochangepasste Anwendungen für mittlere als auch kleinste Stückzahlen.



Frei wählbare Anordnung elektronischer Bauteile.

Designfreiheit in Form und Größe. Integration von Kanälen für Sensoranwendungen möglich.

Individuell angepasste Fertigung für jedes Package möglich.

Verbindung der Komponenten durch Metallisierung und Strukturierung bei niedrigen Temperaturen.

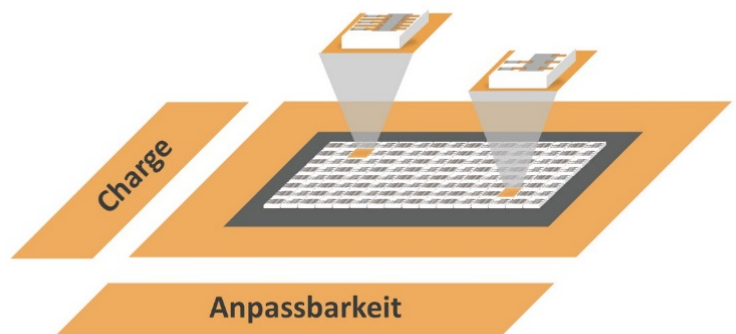
KONEKT kombiniert dazu neue additive Fertigungsverfahren mit Leiterplattenprozessen und erreicht damit eine Steigerung der Designfreiheit für Elektronische Packages.

Neue Möglichkeiten

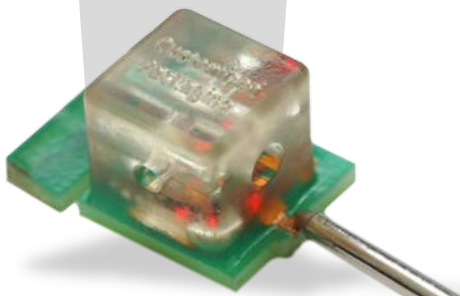


Ab Frequenzen oberhalb von ca. 80 GHz wirken Wirebond-Verbindungen wie Antennen und stören die eigene Signalübertragung. Impedanzangepasste Kupferverbindungen erlauben höhere Übertragungsfrequenzen und somit leistungsstärkere Sensoren.

Neue Märkte



Die KONEKT Technologie bietet für die Industrie 4.0 die Kombination von Anpassbarkeit und Skalierbarkeit auch für große und kleinen Firmen und ist wirtschaftlich vom Prototyping bis zur Großserie.



Gefördert durch:



eXIST
Existenzgründungen
aus der Wissenschaft



**Zusammen.
Zukunft.
Gestalten.**

Technische Universität Dresden – IAVT
Tobias Tiedje
Helmholtzstraße 10
01069 Dresden